FOR IMMEDIATE RELEASE

# SMART Modular世邁科技推出全新BGAP520 PCIe NVMe固態硬碟

## *提供M.2 1620 BGA封裝及 M.2 2230尺寸 滿足工業嵌入式市場需求之焊接式與小尺寸模組*

***台北，2021年2月24日 -*** 全球專業記憶體與儲存解決方案的領導品牌SMART Modular[世邁科技](https://www.smartm.com/index.asp)（NASDAQ: SGH）宣佈推出專為工業嵌入式應用所設計之新PCIe NVMe SSD產品線。此款BGAP520 PCIe NVMe系列提供M.2 1620 BGA封裝及M.2 2230小型單面模組，適用於空間有限的嵌入式系統。

BGAP520 PCIe NVMe為SMART Modular世邁科技DuraFlash™系列的最新產品，針對工業嵌入式市場提供耐用及可靠的快閃記憶體解決方案。DuraFlash™產品符合高標準要求，在極端冷熱溫度、劇烈震動、濕度、鹽霧、沙塵，以及曝露於二氧化硫等最嚴苛環境下仍可運作。

SMART Modular世邁科技新PCIe NVMe系列提供M.2 1620 BGA封裝及M.2 2230模組，可滿足嵌入式系統所需的下焊式及小尺寸快閃儲存記憶體。新產品採用PCIe Gen3 x4傳輸界面，相容於NVM Express v1.3標準，提供包括3D NAND TLC版，容量介於30GB至240GB，可運作於0 °C至70 °C商規環境溫度，以及pSLC版 ，備有20GB至80GB容量可選擇，並可於-40 °C 至85 °C工業等級環境溫度下運作。

SMART Modular世邁科技BGAP520 BGA NVMe與M.2 2230產品特色：

* 內建最新控制晶片與3D NAND科技
* 支援PCIe Gen3 x 4傳輸界面
* 相容NVMe v1.3規格
* BGA NVMe符合M.2 1620封裝標準
* M.2 2230模組符合 M.2 2230 S2-M模組標準
* TLC版本提供30GB至240GB容量、可操作於0 °C至70 °C商用溫度
* pSLC版本提供20GB至80GB容量、可操作於-40 °C至85 °C工業寬溫

SMART Modular世邁科技快閃記憶體Product Director Victor Tsai表示，「SMART Modular世邁科技為想把嵌入式記憶體與儲存裝置整合進自家技術的企業開發出最先進的解決方案。此次新推出的BGAP520 PCIe NVMe SSD具備M.2 1620 BGA封裝與M.2 2230尺寸模組，可提供設計人員堅固耐用，同時保有卓越性能的快閃記憶體解決方案，而我們也樂見客戶整合這些新品到他們的IIOT裝置。」

欲瞭解更多產品資訊，請參考[BGAP520 PCIe NVMe M.2 1620 BGA封裝](https://www.smartm.com/product/959)以及[BGAP520 M.2 2230模組](https://www.smartm.com/product/949)。

### 關於SMART Modular世邁科技

全球專業記憶體與儲存解決方案的領導者SMART Modular世邁科技於美國加州成立超過三十年，為美國那斯達克掛牌上市公司 (NASDAQ: SGH)，致力於開發中高階工業及企業級嵌入式記憶體產品，包含DRAM記憶體模組、SSD固態硬碟、混合式解決方案等，除了標準化與強固型規格外，更針對不同產業應用提供客製化服務，跨足電腦、網通、電信、儲存設備、移動裝置、軍事、航空及工業應用等。SMART Modular世邁科技提供高度客製化的產品設計能力、嚴謹可靠的測試服務與即時專業的技術支援，並與全球領導OEM客戶緊密合作，從產品設計到上市，均能提供高效可靠的解決方案，滿足各類工控產業的需求。更多資訊請參考: <http://www.smartm.com>